

苏州天脉导热科技股份有限公司 关于增加公司及子公司申请银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“苏州天脉”或“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司及子公司申请银行授信额度的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、已审批授信情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第九次会议、于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》，根据公司经营计划安排，为满足公司日常生产经营、流动资金及投资计划的资金需求，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元（含本数）的综合授信额度，有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、本次拟增加申请银行授信额度情况

根据公司及子公司日常生产经营和投资计划的资金需求，结合公司实际情况，公司及子公司拟在原审议通过的授信额度基础上，增加不超过人民币 5 亿元（含本数）的综合授信额度。银行授信内容包括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资方式、融资期限、实施时间等按与银行最终协商的内容和方式执行。本次增加申请授信额度后，公司及子公司向银行申请综合授信额度（含新增授信、原有授信续签授信和原有存续授信）合计不超过 20 亿元（含

本数）。

以上授信额度不等于公司及子公司的融资额度，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求及银行最终批准确定。

公司提请董事会授权董事长或其授权代理人在额度范围内审批具体事宜（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），并与银行签署上述授信事宜项下的相应法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。上述增加授信额度事项及授权有效期自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至 2026 年 5 月 14 日止。在授信额度有效期内，授信额度可循环使用。

本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、对公司的影响

本次增加公司及子公司银行授信额度是为了满足日常经营及投资计划的资金需求，有利于优化公司财务结构，提高资金使用效率，符合公司整体利益。本次增加综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

苏州天脉导热科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日